



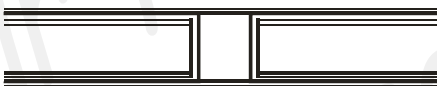

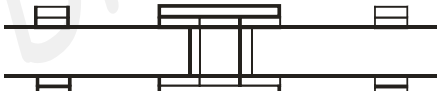
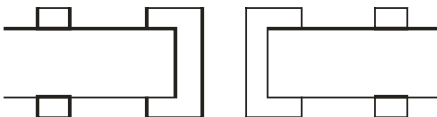


Abbildung 27: Tentingtechnik

Für durchkontaktierte Leiterplatten:

1.  Basismaterial
2.  Bohren
3.  Durchkontaktieren
chemisches Verkupfern
4.  galvanisches Verkupfern
(25 µm)
5.  Aufbringen des Fotoresists
6.  Fotoresist-Entwicklung
7.  Ätzen
8.  Strippen